

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示内容：

- 被担保人名称：深圳市深科达半导体科技有限公司。
- 本次担保金额：公司为全资子公司深圳市深科达半导体科技有限公司（以下简称“深科达半导体”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保，本次担保金额为 7,000.00 万元。截至本公告日，公司对全资及控股子公司的担保余额为 16,500.00 万元。
- 本次公告担保无反担保。

一、担保情况概述

公司于2025年4月25日和2025年5月19日，分别召开了第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司、控股子公司提供预计不超过2.85亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限以正式签署的担保协议为准。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司深科达半导体向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保，担保金额为 7,000.00 万元。本次担保额度在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。

二、被担保情况概述

1、名称：深圳市深科达半导体科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、成立时间：2016 年 7 月 4 日

4、法定代表人：黄奕宏

5、注册资本：410.256 万元人民币

6、经营范围：一般经营项目是：软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），许可经营项目是：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务。

7、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

序号	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
1	资产总额	29,408.29	32,102.17
2	负债总额	20,469.47	21,985.53
3	净资产	8,938.82	10,116.64
序号	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
1	营业收入	18,437.10	9,775.25
2	净利润	1,495.56	962.52

注：2024 年财务数据已经会计师事务所审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

1、担保人名称：深圳市深科达智能装备股份有限公司

2、被担保人名称：深圳市深科达半导体科技有限公司

3、担保方式：连带责任担保

4、担保金额：合同项下所产生的主债权本金（最高限额为 7,000.00 万元人民币）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权益的费用

5、担保期限：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 16,500 万元（全部为公司对全资及控股子公司的担保，其中对深科达半导体担保余额为13,500.00万元），对外担保余额分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 10.25%及 19.37%，公司不存在违规担保、逾期担保情形。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日